

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20260916

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司“2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会”的投资者
时间	2026年9月16日（周三）下午14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：陈杰 副董事长兼总裁：李天池 财务总监：杨秋平 董事会秘书：佟晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 你好，请问现在股东人数是多少 答：您好！截至2026年9月10日，公司股东总户数约为22万户。感谢您的关注！ 2. 公司目前新增业务是不是得明年放量，今年原来的特种业务还有增速吗？自动驾驶、具身机器人、低空飞行器这些领域竞争激烈，相关上市公司业绩除了个别表现不佳，例如自动驾驶的黑芝麻地平线，公司如何有后发优势，具身机器人相关上升公司业绩也不佳，如何领先？这些行业原有的龙头都表现一般，公司如何有优势？ 答：您好！AI+视觉感知、eSIM芯片在通讯端的应用、车规级域控芯片等在下半年会持续放量。公司拟投资进入的自动驾驶芯片领域，可有效利用紫光同芯的客户资源与产业化能力，丰富

	公司的产品矩阵,进一步提升公司的综合竞争力。感谢您的关注! 3. 紫光国微近五年来,超过 60 亿的研发资金,请问有什么拿的出手的拳头产品或者专利? 答:您好!公司持续在加大研发投入,每年都有新增获得发明专利及实用新型专利,保持在特种集成电路、智能安全芯片领域的行业龙头地位。感谢您的关注! 4. 公司现在价格已经在股权激励价格之下,这股权激励还有意义吗? 答:您好!公司实施的股权激励计划中各年业绩考核目标,是结合了公司业务情况、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定。公司持续深耕主业,强化经营管理,优化资源配置,推动公司稳健发展,努力争取更好的经营成果。感谢您的关注! 5. 董秘,全资子公司参股深圳科技大楼,为何至今完工?有过展吗? 答:您好!截至 2026 年 6 月底,公司募投项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”投资进度为 22.22%。该募投项目原计划将于 2025 年 7 月达到预定可使用状态,由于项目在施工过程中遇到违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况,结合项目建设实际进度,为审慎起见,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月底。 6. 董事长您好:日前您与美国 ARM 公司总裁会面时谈到,双方会加强合作,请问双方有没有具体的意向及时间表? 答:您好!新紫光集团联席总裁陈杰先生在 Arm Everywhere China 年度大会上宣布与 Arm 深化战略合作。相关信息请以新紫光集团公开报道为准。感谢您的关注! 7. 公司收购紫光曲率同芯部分股份的目的是什么?是为了做智驾核心芯片,还是相关的非核心的端侧 AI 智驾芯片。目前智驾芯片,英伟达/地平线/华为/比亚迪都开发了好几代,技术积累雄厚。紫光曲率同芯和紫光智行,公开数据显示,名下无专利和社保人员,看起来是新公司。此公司是否有相关技术积累,公司介入此赛道的技术优势在哪里。这么晚的时间,才开始入场布局智驾芯片,能否有投入产出? 答:公司全资子公司紫光同芯收购紫光曲率同芯 38%股权的目的是拓展智驾芯片业务。紫光同芯目前已布局车规域控芯片、
--	---

	车规安全芯片、功率器件等产品，但在智驾芯片领域存在产品空白。通过本次投资，可补齐智驾芯片这一关键品类，结合紫光同芯积累的客户资源与产品化能力，为主机厂、Tier1 客户提供多种产品和解决方案的组合，进一步丰富产品矩阵，提升公司在汽车电子领域的综合竞争力。感谢您的关注！ 8. 公司特种 HBM 目前研发进展怎么样？如果后续量产，需求是否强烈？如果没量产，目前研发进度怎么样？卡点在哪里？ 答：您好！公司面向特种行业应用的 HBM 产品还需要持续迭代。感谢您的关注！ 9. 请问贵公司怎么维护公司市值管理？ 答：您好！公司董事长、其他董事、高级管理人员及其他人员等 11 人已于 2026 年 8 月 26 日增持公司股份。同时，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，公司统筹业绩增长与股东回报，实现动态平衡，自 2005 年上市至 2025 年末，公司累计实施现金分红方案 19 次，分红金额达 141,921.08 万元；实施以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 2 次，累计回购金额达 79,994.55 万元。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，切实维护广大投资者的利益。 10. 紫光国微，净资产高，业绩也好，技术壁垒也高得很，新产品量产及送样成功也很多，怎么好的股票在 AI 高科技行情这么好的年份还下跌了这么多，是什么原因？ 答：您好！公司股价受宏观经济、市场环境、投资者风险偏好等多种因素影响。公司将立足提升公司质量，提升经营效率和盈利能力，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，切实维护广大投资者的利益。感谢您的关注！ 11. 杨总监您好，贵公司近几年分红比例相对不高，能否增加中报分红。谢谢！ 答：您好！公司半年度报告已经公司董事会批准报出，公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。感谢您的关注！ 12. 董秘好，公司沟通中多次讲，将集团 AI 资源注入公司，至今未见动静。是何原因？另公司研究院进展如何？谢谢！ 答：您好！公司中央研究院重点布局了端侧 AI 芯片、特种图像传感器及二维材料半导体器件等多个方向，同时开展其他前
--	---

	沿技术的跟踪布局。 端侧 AI 芯片方面，公司瞄准视频图像端侧 AI 处理场景，典型应用包括无人机等领域。目前该产品已向部分重点客户提供试用，客户反馈良好，相关工作取得实质性进展。 特种图像传感器（CIS）方面，公司第一代特种 CIS 产品已向客户送样，客户反馈良好，产品毛利率水平较为理想。在系统方案层面，公司致力于从单一芯片向平台化解决方案演进，以无人机应用为例，可提供“端侧 AI 芯片+图像传感器”配套方案，并逐步扩展至电源管理芯片、存储芯片及 FPGA 等器件，形成完整的平台化解决方案，提升客户使用便利性与产品附加价值。 二维材料半导体器件方面，公司已与国内顶级高校院士团队开展合作，共同推进二维材料半导体器件研发。 13. 董事长您好，我已投资贵司二十一年，近几年业绩下滑股价腰斩，远跟不上行业发展，是何原因？规划失误？未来几年能否交上一份好答卷。本月深圳半导体会展末找到贵司展位，是否未参展，来听到您讲展，下次能公开讲课时间及展位。 答：您好！公司股价受宏观经济、市场环境、投资者风险偏好等多种因素影响。公司将立足提升公司质量，提升经营效率和盈利能力，希望用更好的业绩表现回馈广大投资者。2026 年 9 月 9 日，IICIE 国际集成电路创新博览会，公司携旗下紫光同芯、国芯晶源前沿产品重磅亮相，公司董事长陈杰受邀参加开幕式暨集成电路创新高峰论坛，并发表《面向商业航天与后摩尔技术的集成电路产业创新实践》主题演讲。感谢您的关注！ 14. 董秘好，问一下岳阳晶源产生效益了吗？唐山晶源能有突破性发展？另汽车芯片进展如何？ 答：您好！截至目前，公司位于岳阳的超微型石英晶体谐振器生产基地部分产线已转固，部分产线处于调试和建设阶段。公司汽车控制芯片 THA6 系列第一代产品应用于多款量产车型，第二代产品导入多家头部主机厂和 Tier1，正积极推进客户端量产。公司重点发展汽车域控芯片，正在积极导入用户，提升供货能力。 15. 董秘好，瑞能半导体资产并购进展如何？谢谢 答：您好！公司已于 2026 年 9 月 12 日披露关于深交所审核问询函回复的修订稿及相关公告，公司一直在全力推进此项工作，敬请留意公司后续公告。 16. 董事长好！想问下董事长是否对 2025 年股票期权激励计
--	--

	划的任务有信心！ 答：您好！公司推出 2025 年股票期权激励计划，核心目的是将团队利益与股东长期利益保持一致。股权激励计划中各年业绩考核目标，是结合了公司业务情况、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定。公司持续深耕主业，强化经营管理，优化资源配置，推动公司稳健发展，努力争取更好的经营成果。感谢您的关注！ 17. 你好，公司今后的成长点在什么地方。 答：您好！关于公司未来几年的经营战略，主要如下：第一，基于特种集成电路与智能安全芯片业务已经处于行业领导地位，未来几年公司会持续推进产品技术迭代，开拓更多产品应用场景，做好成本控制，持续高质量发展。第二，重点发展汽车域控芯片，加大研发投入，积极导入用户，持续创造价值；第三，由中央研究院牵头，积极布局其他新领域，包括面向自动驾驶、具身机器人、低空飞行器等应用的端侧 AI 芯片新架构、新模型和高效算法研究，基于二维材料器件的新型存储器和特种芯片，高性能特种图像传感器芯片等。感谢您的关注！ 18. 2015 年后的计划投资项目均为实施！你现在的投资资本不认好，主要是近几年的发展速度平淡无奇，公司有长远的发展战略规划吗？ 答：您好！关于公司未来几年的经营战略，主要如下：第一，基于特种集成电路与智能安全芯片业务已经处于行业领导地位，未来几年公司会持续推进产品技术迭代，开拓更多产品应用场景，做好成本控制，持续高质量发展。第二，重点发展汽车域控芯片，加大研发投入，积极导入用户，持续创造价值；第三，由中央研究院牵头，积极布局其他新领域，包括面向自动驾驶、具身机器人、低空飞行器等应用的端侧 AI 芯片新架构、新模型和高效算法研究，基于二维材料器件的新型存储器和特种芯片，高性能特种图像传感器芯片等。感谢您的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 16 日